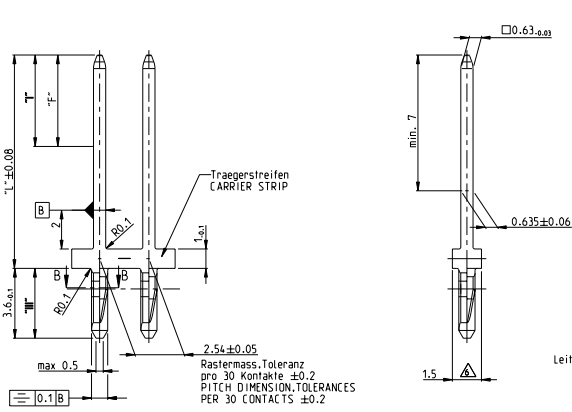
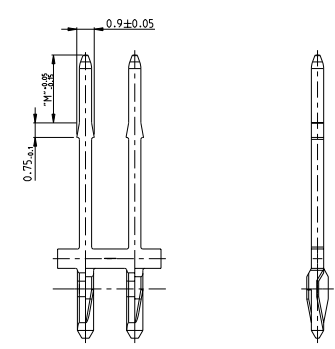


REV. NO.	DATE	REVISIONS	BY	CHK
A1	-	REVISED PER ECO-11-005150		

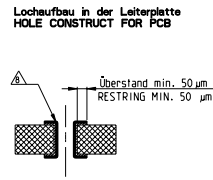
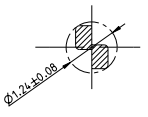
VERSION A



VERSION B



B-B
20:1



Durchplattierte Bohrung Spezifikation PLATING ACROSS OF HOLE SPEC.			
Lochbau / P HOLE CONSTRUCT PCB	△	△	△
Kupferschicht COPPER COATING	25-75 µm	25-75 µm	25-50 µm
Zinn/Blei Schicht TIN/LEAD COATING	4-10 µm	-	-
Zinn Schicht TIN COATING	-	-	0.5-1.5 µm
Nickel Schicht NICKEL COATING	-	max. 5 µm	-
Gold Schicht GOLD COATING	-	max. 0.2 µm	-
Bohr-Ø HOLE DIA.	1.15±0.025	1.15±0.025	1.15±0.025
Plattierter Ø PLATED DIA.	0.94+0.15	0.94+0.15	1.07-0.045

Oberfläche/SURFACE	
Zone I AREA	Goldausführung: 0.8 µm bis 2 µm Au ueber Ni GOLD VERSION: 0.8 µm TO 2 µm Au OVER Ni Zinn-Ausführung: 1 µm bis 3 µm Sn TIN-VERSION: 1 µm TO 3 µm Sn
Zone II AREA	Schichtdicke: 1.3 µm bis 2.2 µm Ni COAT THICKNESS: 1.3 µm TO 2.2 µm Ni
Zone III AREA	Schichtdicke: 0.8 µm bis 1.8 µm Sn ueber Ni COAT THICKNESS: 0.8 µm TO 1.8 µm Sn OVER Ni

- Bemerkungen
NOTES
1. Massgebend ist der deutsche Text
ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING
 2. Verwendung fuer Leiterplattendicke: 1.6 ±0.14mm
USED ON PCB THICKNESS: 1.6 ±0.14mm
 3. -
 4. Lötbarkeit nach DIN 40046
SOLDERABILITY ACCORDING TO DIN 40046
 5. Kontaktsift siehe Zeichnung, TE 114-18063, Version B
CONTACT PIN SEE DRAWING TE 114-18063, VERSION B
 6. Zustand vor dem Einpressen
STATUS BEFORE INSERTION
 7. Zuessaessige Saebelroemigkeit: 40mm/m
PERMITTED SABLERSHARPNESS: 40mm/m
 8. Einpresszone fuer 1.6mm Leiterplatte
Anforderung an Leiterplattenloch, siehe Tabelle
PRESS-IN AREA FOR 1.6mm PCB
REQUIREMENTS ON PCB HOLE. SEE TABLE
 9. Verpackungseinheit: 50,000 Stck. auf wiederverwendbarer
Kunststoff-Spule Ø 58mm mit Zwischenlagenpapier, 3 Spulen im Karton
PACKAGING UNIT: 50,000 PCS ON REUSABLE PLASTIC REEL DIA.58MM
WITH INTERLEAVING PAPER, 3 REELS IN BOX.
 10. Lochbau (Zinn/Blei) in der Leiterplatte (siehe Tabelle)
HOLE CONSTRUCT (TIN/LEAD) FOR PCB (SEE TABLE)
 11. Lochbau (Nickel/Gold) in der Leiterplatte (siehe Tabelle)
HOLE CONSTRUCT (NICKEL/GOLD) FOR PCB (SEE TABLE)
 12. Lochbau (Zinn) in der Leiterplatte (siehe Tabelle; noch nicht erprobt
nach TE-Spezifikation 108-18643)
HOLE CONSTRUCT (TIN) FOR PCB (SEE TABLE; NOT YET APPROVED ACC. TO TE SPECIFICATION 108-18643)

VERSION	TE CONNECTIVITY ORDER NO.	REV.	MATERIAL	DRIFTSCHICHT SURFACE AREA "F"	BOHRUNG Ø	BOHRUNG TIEFE	BOHRUNG WENDE	BOHRUNG WENDE	BOHRUNG WENDE
A	2-963964-8	A	Zinn/TIN		7	9.2	-	12.8	
A	3-963964-7	A	Gold/GOLD		5.5	11.1	-	14.7	
A	2-963964-7	A	Zinn/TIN		7	11.1	-	14.7	
B	2-963964-6	B	Zinn/TIN		7	13.6	7.75	17.2	
B	2-963964-5	C	CuNiSi F58	S	8.2	17.8	9.25	21.4	
A	9-963964-4	A	Zinn/TIN		7	13.6	7.75	17.2	
A	19-963964-4	B	Zinn/TIN		7	9.8	-	13.4	
A	3-963964-4	A	Gold/GOLD		5.5	9.8	-	13.4	
A	2-963964-4	B	Zinn/TIN		7	9.8	-	13.4	
A	1-963964-4	B	Gold/GOLD		5.5	9.8	-	13.4	
A	2-963964-3	B	Zinn/TIN		7	8.05	-	11.65	
A	1-963964-3	B	Gold/GOLD		5.5	8.05	-	11.65	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. PP. No. 0002002

DATE: 11.05.2005

TE Connectivity

MDS ACTION PIN FOR 1mm HOLE

ACTION PIN fuer 1mm Loch, Freilehend

ST. 00779

963964

CUSTOMER DRAWING